

附件 1

无锡高新区集成电路企业认定条件

为贯彻落实《无锡高新区关于进一步加快推进集成电路产业高质量发展的政策意见（试行）》（锡高管发〔2021〕7号）文件要求（以下简称“政策意见”），参照国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业相关条件，根据高新区集成电路产业实际情况，现制定《无锡高新区集成电路企业认定条件》如下：

一、《政策意见》所称的集成电路设计（含设计服务）企业，必须同时满足以下条件：

（一）在无锡高新区依法设立，从事集成电路设计、电子设计自动化（EDA）工具开发、知识产权（IP）核设计或设计服务，并具有独立法人资格的企业；

（二）上一年度具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系的月平均职工人数不少于5人，其中研究开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于40%；

（三）上一年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于6%；

（四）上一年度集成电路设计（含EDA工具、IP和设计服务）销售（营业）收入占企业销售（营业）收入总额的比例不低

于 50%，其中自主设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于 50%；

（五）企业拥有与集成电路产品设计相关的已授权发明专利、布图设计登记、计算机软件著作权或相关专利申请受理合计不少于 2 个；

（六）具有与集成电路设计相适应的规范软硬件设施等开发环境和经营场所，且必须使用正版的 EDA 等硬件工具。

二、《政策意见》所称的集成电路装备（或关键零部件）企业，经区集成电路产业专家组评审或同时满足以下条件：

（一）在无锡高新区依法设立，从事集成电路专用装备或关键零部件研发、制造并具有独立法人资格的企业；

（二）上一年度具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系的研究开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于 20%；

（三）上一年度集成电路装备（或关键零部件）销售收入占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 30%；

（四）上一年度用于集成电路装备或关键零部件研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 5%；

（五）拥有核心关键技术和自主知识产权，企业拥有与集成电路装备（含关键零部件）研发、制造相关的发明专利数量不少于 2 个或实用新型专利不少于 4 个；

（六）具有与集成电路装备生产相适应的经营场所、软硬件设施等基本条件。

三、《政策意见》所称的集成电路材料企业，经区集成电路产业专家组评审或同时满足以下条件：

（一）在无锡高新区依法设立，从事集成电路专用材料研发、生产并具有独立法人资格的企业；

（二）企业主营产品进入《关于调整集成电路生产企业进口自用生产性原材料消耗品免税商品清单的通知》（财关税〔2015〕46号）的“国家集成电路生产企业进口自用生产性原材料、消耗品免税商品清单”；

（三）上一年度具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系的研究开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于 15%；

（四）上一年度集成电路材料销售收入占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 30%；

（五）上一年度集成电路材料研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 5%；

（六）拥有核心关键技术和自主知识产权，企业已申请受理或拥有与集成电路材料研发、生产相关的已授权发明专利数量不少于 2 个；

（七）研究开发人员占企业当年月平均职工总数的比例不低于 15%；

（八）具有与集成电路材料生产相适应的经营场所、软硬件设施等基本条件。

四、《政策意见》所称的集成电路封装、测试企业，必须同

时满足以下条件：

（一）在无锡高新区依法设立，从事集成电路封装、测试并具有独立法人资格，需符合国家产业政策的企业；

（二）上一年度具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系且具有大学专科以上学历职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例不低于 40%，其中研究开发人员占企业当年月平均职工总数的比例不低于 15%；

（三）上一年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 3%；

（四）上一年度集成电路封装、测试销售（营收）收入占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 60%，且企业销售（营业）收入总额不低于（含）2000 万元；

（五）拥有核心关键技术和自主知识产权，企业拥有与集成电路封装、测试相关的发明专利、计算机软件著作权数量合计不少于 5 个；

（六）具有与集成电路芯片封装、测试相适应的经营场所、软硬件设施等基本条件。

五、《政策意见》所称的集成电路制造企业包括国家鼓励的线宽小于 130 纳米（含）的集成电路生产企业、线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业（含掩模版、8 英寸及以上硅片生产企业）、承担国家重大工程配套任务的集成电路生产（含掩模）企业、先进化合物半导体生产企业以及 6 英寸（含）

以上 MEMS 生产企业。

六、经省级以上发改委、工信部门认定的集成电路企业或经区集成电路领导小组认定的企业可直接申请认定。

七、本条件中所称研究开发费用政策口径，按照《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（2017年第40号）的规定执行。

附件 2

鼓励企业集聚项目申报指南（A1）

一、扶持领域和对象

该项目扶持对象为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，新设立或迁入无锡高新区的集成电路设计、装备和材料企业。

二、申报条件

2021 年新设立或迁入的集成电路设计、装备和材料企业，截至 2021 年 12 月 31 日，累计完成投资（指固定资产、无形资产和费用化的研发投入）300 万元以上，需经第三方机构审计出具意见。

三、扶持标准

1. 补贴面积为实际自用面积（由企业自评、所属街道（园区）或招商部门进行面积复核），设计类企业以实用办公面积计算，生产类企业以投入生产的厂房面积计算。

2. 设计企业办公楼人均补贴面积不超过 25 平方米，装备和材料企业厂房人均补贴面积不超过 60 平方米，以上人数均以企业在高新区缴纳社保或个税总人数（2021 年平均数）为基准。

3. 每家企业年度资助最高 200 万元。

四、申报材料

1. 项目申报书（模板见附件 18）；

2.企业情况报告：

所有制性质、注册资金和日期、主营业务、产品及工艺水平、项目总投资规模、投资人基本情况及主要股东的概况、人员配置等。

3.相关证明材料复印件：

(1) 单位证照（统一社会信用代码证和法定代表人身份证等）；

(2) 上年度未发生重大安全生产和重大环境污染事故的承诺书；

(3) 累计投资 300 万元以上的第三方审计报告；

(4) 申请补助金额的计算明细及注明补贴期限；

(5) 产生的社会及经济效益情况（利税缴纳证明、员工社保缴纳证明、专利或其他科技成果证明材料）；

(6) 房租合同及付款发票；

4.无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

5.项目申报承诺书（模板见附件 19）。

五、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

附件 3

支持项目优先布局(实缴资本)申报指南(A2-1)

一、扶持领域和对象

该项目扶持对象为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，新设立或迁入无锡高新区的集成电路设计（含 EDA 开发、IP 核设计、设计服务）企业。

二、申报条件

2021 年新设立或迁入无锡高新区，且实缴资本超过 300 万元的集成电路设计（含 EDA 开发、IP 核设计、设计服务）企业。

三、扶持标准

经专家评审，对其核心技术、工艺水平和市场前景认定后，按照企业实缴资本，给予不超过 20% 的补贴，补贴总额不超过 500 万元。

四、申报材料

1. 项目申报书（模板见附件 18）；

2. 企业情况报告：

所有制性质、注册资金和日期、主营业务、项目总投资规模、投资人基本情况及主要股东的概况、人员配置等。

3. 相关证明材料复印件：

（1）单位证照（统一社会信用代码证、法定代表人身份证

等)；

(2) 上年度未发生重大安全生产和重大环境污染事故的承诺书；

(3) 项目专项审计报告(含投资清单及相关票据复印件、证明、董事会决议等)。

4. 无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

5. 项目申报承诺书(模板见附件19)。

五、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

附件 4

支持项目优先布局(固定资产投资)申报指南(A2-2)

一、扶持领域和对象

该项目扶持领域和对象为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，新设立或迁入无锡高新区的集成电路装备及零部件企业。

二、申报条件

1.关键装备是指用于晶圆制造环节的装备及核心零部件，用于封装测试环节及用于化合物集成电路衬底、外延材料及 8 英寸以上单晶硅片生产的装备；

2.固定资产投资（含）需经第三方机构审计，出具专项审计报告；

3.五免五减半（企业所得税及增值税）奖励时间从 2021 年度起算。

三、扶持标准

新引进或新迁入的集成电路装备及零部件企业经专家评审认定后，按照三年内固定资产投资给予不超过 10%、最高 1 亿元补贴；按照地方经济贡献，给予五免五减半奖励。

四、申报材料

1.项目申报书（模板见附件 18）；

2.企业情况报告：

(1) 项目运营情况和财务状况

所有制性质、注册资金和日期、主营业务、上年度的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、投资人基本情况及主要股东的概况等。

(2) 项目建设情况

项目建设的主要目标、建设规模、资金使用方案、适用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容、建设地点、进度安排等。

3. 相关证明材料复印件：

(1) 单位证照(统一社会信用代码证和法定代表人身份证)；

(2) 企业 2021 年度财务审计报告；

(3) 项目专项审计报告(含投资清单及相关票据复印件、证明、董事会决议等)；

(4) 上年度未发生重大安全生产和重大环境污染事故的承诺书；

(5) 产生的社会及经济效益情况(利税缴纳证明、员工社保缴纳证明、专利或其他科技成果证明材料)。

4. 无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

5. 项目申报承诺书(模板见附件 19)。

五、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；
无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

附件 5

支持项目优先布局(重大项目)申报指南(A2-3)

一、扶持领域和对象

该项目扶持领域和对象为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日之间，新设立或迁入的集成电路制造、封装、测试和材料等企业。

二、申报条件

1.投资额 5 亿元（含）以上的企业，以区级以上行政审批部门的立项批复为准，8 吋、12 吋线制造及投资额超过 10 亿元的封装测试等相关项目需通过各级发改委、工信部门指导，固定资产投资需经第三方机构出具专项审计报告。

2.首次申报时项目必须已完成投资进度的 40%，末次兑现时项目需按立项时投资金额完成投资，申报周期 3 年。

三、扶持标准

新引进投资额 5 亿元（含）以上的制造、封装、测试和材料等企业，经专家评审通过后，按照三年内固定资产投资给予不超过 8%、最高 4 亿元补贴。

投资额在 5 亿元以上、10 亿元以下的企业，按投资额的 6% 给予补贴；投资额在 10 亿元以上、30 亿元以下的企业，按投资额的 7% 给予补贴；投资额在 30 亿元以上的企业，按照投资额的 8% 给予补贴。

四、申报材料

1.项目申报书（模板见附件 18）；

2.企业情况报告：

（1）项目运营情况和财务状况

所有制性质、注册资金和日期、主营业务、上年度的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、投资人基本情况及主要股东的概况等。

（2）项目建设情况

项目建设的主要目标、建设规模、技术路线、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等。

3.相关证明材料复印件：

（1）单位证照（统一社会信用代码证和法定代表人身份证）；

（2）上年度未发生重大安全生产和重大环境污染事故的承诺书；

（3）企业 2021 年度财务审计报告；

（4）项目专项审计报告（含投资清单及相关票据复印件、证明、董事会决议等）；

（5）产生的社会及经济效益情况（利税缴纳证明、员工社保缴纳证明、专利或其他科技成果证明材料）。

4.无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

5.项目申报承诺书（模板见附件 19）。

五、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

附件 6

支持关键领域企业规模化发展申报指南（A3）

一、扶持领域和对象

该项目扶持领域和对象为在无锡高新区（新吴区）登记、注册和纳税的集成电路企业。

二、申报条件

1.企业连续 2 年应税销售收入正增长，且 2021 年度首次达到一定规模的集成电路设计、装备、材料及关键零部件企业。

2.年度应税销售每上一个台阶奖励一次、实施晋档补差。企业核心团队总人数不超过 10 人。

三、扶持标准

1.对拥有自主知识产权产品的设计企业，年度应税销售收入首次突破 5000 万元、1 亿元、5 亿元、10 亿元、20 亿元的，给予企业核心团队 100 万元、150 万元、300 万元、600 万元、1300 万元的一次性奖励。

2.对拥有自主知识产权产品的集成电路装备和材料企业，年度应税销售收入（只含自主研发产品）首次突破 5000 万元、1 亿元、5 亿元、10 亿元的，经认定后分别给予企业核心团队 200 万元、800 万元、1200 万元、1500 万元的一次性奖励。

3.对于用于关键装备的核心零部件企业，应税销售收入（只

含自主研发产品)首次突破1000万元、2000万元、5000万元、1亿元的,给予企业核心团队50万元、100万元、200万元、400万元一次性奖励。

四、申报材料

1.项目申报书(模板见附件18);

2.企业近三年经营情况(公司架构、股东情况、经营业绩、主要技术及产品情况、重点项目、未来发展等)、核心团队信息(核心团队企业简介、身份证号、毕业院校、学历证明、劳动合同复印件、社保或个税证明等)、上年度未发生重大安全生产和重大环境污染事故的承诺书;

3.相关材料复印件:单位证照(统一社会信用代码证)、法定代表人身份证、2019-2021年企业财务审计报告;

4.无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》;

5.项目申报承诺书(模板见附件19)。

五、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛,电话:81890922;

区工信局信息产业处 臧 鑫,电话:81891293;

无锡市半导体行业协会 陈立明,电话:85380170。

鼓励产业链互动项目（专用设备）申报指南 （A4-1）

一、扶持领域和对象

该项目扶持领域和对象为在无锡高新区（新吴区）登记、注册和纳税的集成电路企业。

二、申报条件

1. “装备企业生产的拥有自主知识产权的首台关键专用装备”是指企业研发的新款定型装备。

2. 该条款支持的“关键专用装备”是指符合国家鼓励政策，需经专家评审通过。

3. 补助金额计算依据以实际开票金额为准，且开票日期需要在 2021 年内。需跨年度支付的合同，根据开票日期分别在当年度进行申报。

三、扶持标准

1. 支持区内集成电路企业采购区内装备企业生产的拥有自主知识产权的首台关键专用装备，按照采购金额的 25%，一次性给予最高 500 万元的资助。

2. 对于区内集成电路关键专用装备企业自主研发的装备首次在集成电路企业出售的，给予首台装备销售额的 25% 支持，一

次性给予最高 500 万元的资助。

四、申报材料

1.项目申报书（模板见附件 18）；

2.项目申报书面材料：

（1）企业基本情况：所有制性质、注册资金、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及股权等概况；

（2）企业提供合作双方不存在股权关联关系的承诺说明；

（3）产品/服务的用途及质量评价（如有多个合同，请分别列明）；

（4）上年度未发生重大安全生产和重大环境污染事故的承诺书；

3.相关证明材料复印件：单位证照（统一社会信用代码证），法定代表人身份证，上年度财务审计报告，相关合同及票据等。

4.无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

5.项目申报承诺书（模板见附件 19）。

五、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

附件 8

鼓励产业链互动项目（新增产能）申报指南 (A4-2)

一、扶持领域和对象

该项目扶持领域和对象为在无锡高新区（新吴区）登记、注册和纳税的集成电路企业。

二、申报条件

1.“封装和测试、代工流片”是指申报年度内，为区内企业开放的新增产能。

2.补助金额计算依据以实际开票金额为准，且开票日期需要在 2021 年内。

三、扶持标准

1.对为集成电路设计企业进行封装和测试的企业（不含关联企业），按照封装测试费用 5%的比例给予支持，对单个企业年度支持总额不超过 200 万元。

2.对集成电路制造企业开放产能为区内企业代工流片的，按照每片（折合 8 吋片）100 元的标准给予资金支持，对单个企业年度支持总额不超过 1000 万元。

四、申报材料

1.项目申报书（模板见附件 18）；

2.项目申报书材料：

(1) 企业基本情况：所有制性质、注册资金、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及股权等概况；

(2) 企业提供合作双方不存在股权关联关系的承诺说明；

(3) 新增产能的相关证明材料（如：前后两年区内合作企业的合同等）；

(4) 上年度未发生重大安全生产和重大环境污染事故的承诺书；

3. 相关证明材料复印件：单位证照（统一社会信用代码证），法定代表人身份证，上年度财务审计报告，相关合同及票据等。

4. 无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

5. 项目申报承诺书（模板见附件 19）。

五、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

附件 9

鼓励企业兼并重组申报指南（A5）

一、扶持领域和对象

该项目扶持对象为在无锡高新区（新吴区）登记、注册和纳税，且在 2021 年内完成并购的集成电路企业。

二、申报条件

1. 并购对象为国内外集成电路设计或装备企业；
2. 交易额需大于 1000 万元；
3. 交易时间在补贴时间内，并已完成实际交易。

三、扶持标准

对成功并购国内外集成电路设计或装备企业，并购方对目标企业的实际现金购买价格、承担债务金额或目标企业净资产作价入股金额超过 1000 万元的，最高按照并购实际发生金额的 10% 给予并购补贴，单个项目总额不超过 1000 万元。

四、申报材料

1. 项目申报书（模板见附件 18）；
2. 相关材料复印件：单位证照（统一社会信用代码证），法定代表人身份证，上年度的财务报表，上年度的纳税证明，兼并重组或投资合作的证明材料；
3. 相关情况报告：

(1) 企业基本情况：企业概况、所有制性质、注册资金、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况等；

(2) 被兼并企业基本情况：被兼并企业概况、主营业务、技术工艺情况、实际现金并购价格、上年度财务报表、承担债务金额或目标企业净资产作价入股金额等；

4.无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

5.项目申报承诺书（模板见附件 19）。

五、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

支持新产品研发项目（流片补贴）申报指南 （A6-1）

一、扶持领域和对象

该项目扶持领域和对象为无锡高新区（新吴区）范围内的集成电路设计类企业。

二、申报条件

1.项目开票日期在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日内。

2.政策中规定的“产品”是指经过掩模版（FullMask 或者 MPW）流片，达到设计要求后，可以提供给集成电路系统整机厂商进行芯片性能测试及示范应用的非量产用芯片产品。

3.政策中规定的“首轮流片”是指设计企业就本“产品”，首次与制造企业签订流片合同，利用其生产线流片的过程。

4.除分立器件、传感器和光电子类产品外，其他产品线宽须小于 $0.25\mu\text{m}$ （含）。

5.原则上，单个产品首轮流片 8 英寸 wafer 数量不超过 15 片，12 英寸 wafer 数量不超过 10 片。

三、扶持标准

1.MPW 补贴以集成电路设计企业设立之日到申报截止日计算，1-3 年企业给予 70%补贴；3 年以上企业给予 60%补贴。

2.对拥有自主知识产权产品的工程批流片：本地 IC 企业在外地工厂代加工的，给予首轮掩模版制作费用的 40%和流片费用的 50%的补贴。本地 IC 企业在本地工厂代加工的，给予首轮掩模版制作费用的 50%和流片费用的 60%的补贴。

3.单个企业（单位）每年流片补贴总额不超过 500 万元，对线宽小于 45nm（含）的每年补贴总额不超过 2000 万元。

四、申报材料

1.项目申报书（模板见附件 18）；

2.相关材料复印件：单位证照（统一社会信用代码证）；法定代表人身份证；掩模制版、流片合同，付款凭证及完税发票；

3.项目情况报告：

（1）企业基本情况：所有制性质、注册资金、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况等；

（2）项目基本情况：项目或产品基本情况，技术工艺情况，掩模制版、流片情况等；

（3）项目投资情况：研发费用情况，项目或产品总投资情况，资金来源等；

4.集成电路产业 A6 项目专项补贴汇总表（见下文）

5.无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

6.项目申报承诺书（模板见附件 19）。

2022 年度无锡高新区集成电路产业 A6 项目专项补贴汇总表 (2021.1~2021.12)

单位名称:										填表人:			
项目名称	补贴种类	产品型号	流片单位	流片工艺	wafer 片数	年	月	凭证号	发票号码	开票日期	金额(税前)	申请补贴 (元)	
	MPW												
	工程批												
小计											-		
项目名称	补贴种类	产品型号	掩模单位	流片工艺	MASK 数量	年	月	凭证号	发票号码	开票日期	金额(税前)	申请补贴 (元)	
	掩模制版 (首套)												
小计											-		
总 计													
申报单位盖章:										日期:			

五、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

附件 11

支持新产品研发项目(IP 补贴)申报指南(A6-2)

一、扶持领域和对象

该项目扶持领域和对象为无锡高新区(新吴区)范围内的集成电路设计类企业,但不限于相关资质。

二、申报条件

1.项目开票日期在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日内。

2.支持补贴的 IP(硅知识产权)供应商品牌:ARM、Synopsys、Imagination Technologies、Cadence、Ceva、Rambus、eMomery Technology、Achronix、SST、Wave computing、芯原股份、平头哥、芯来、芯动、华大九天、橙科微、IPGoal、Actt、Artiris、晶心科技等 IP 供应商。

三、扶持标准

对集成电路设计企业购买 IP(硅知识产权)(专业 IP 提供商、或者 Foundry 厂、EDA 供应商)开展芯片研发,给予 IP 购买费用 50%补贴,单个企业每年最高不超过 500 万元。

四、申报材料

1.项目申报书(模板见附件 18);

2.相关材料复印件:单位证照(统一社会信用代码证);法定代表人身份证;IP 购置合同,付款凭证及完税发票;

3.项目情况报告:

(1) 企业基本情况：所有制性质、注册资金、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况等；

(2) 项目基本情况：项目或产品基本情况，技术工艺情况，IP 使用情况，研发费用情况，项目预期目标等；

4. 无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

5. 项目申报承诺书（模板见附件 19）。

五、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

支持新产品研发项目（研发奖励）申报指南 （A6-3）

一、扶持领域和对象

该项目扶持领域和对象为无锡高新区（新吴区）范围内的集成电路设计类企业，但不限于相关资质。

二、申报条件

1.企业须按规定到税务部门办理完成 2021 年度研发费用税前加计扣除手续；

2.纳入支持范围的研发费用是 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日之间。

三、扶持标准

对从事集成电路 EDA 开发、IP 核研发的企业，给予研发费用加计扣除部分的 50%奖励，单个企业每年最高不超过 3000 万元。

四、申报材料

1.项目申报书（模板见附件 18）；

2.相关材料复印件：单位证照（统一社会信用代码证）；法定代表人身份证；上年度财务审计报告（带二维码）；付款凭证及完税发票；

3.项目情况报告：

(1) 企业基本情况：所有制性质、注册资金、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况等；

(2) 项目基本情况：项目或产品基本情况，研发费用情况，技术工艺情况，项目或产品总投资情况、资金来源等；

(3) 项目预期目标：经济目标、社会效益、布图、专利数量等；

(4) 税务系统导出的企业所得税年度纳税申报表（上传电子版全套表单）；

(5) 研发费用加计扣除部分的明细表（加盖公章）

4. 无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

5. 项目申报承诺书（模板见附件 19）。

四、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

鼓励集成电路企业资质备案项目申报指南（A7）

一、扶持领域和对象

该项目扶持对象为在无锡高新区（新吴区）登记、注册和纳税的集成电路企业，且在 2021 年度获批相关认证。

二、扶持标准

1.汽车电子车规级认证补贴：对取得 IATF16949：2016 认证的，给予 3 万元一次性补贴。

2.对取得 ISO26262 认证的，给予 50 万元一次性补贴。

3.对通过合格汽车电子客户（年产值超过 5000 万元，需提供证明材料）审核和出具通过 AEC-Q100 审核报告并形成销售的，按照 AEC-Q100 认证直接费用的 50% 予以补贴（需提供 AEC-Q100 认证费用发票），最高不超过 100 万元。

4.首次通过“国家鼓励的重点集成电路设计企业”备案的，给予 100 万元的一次性奖励。

5.对取得集成电路布图设计证书的，按每件 2000 元补贴。

6.对获批国家级创新中心建设的，参照上级配套资金，每年给予不超过 2000 万元的一次性建设补助，补贴不超过 3 年，总金额不超过 5000 万元。

三、申报材料

1.项目申报书（模板见附件 18）；

2.相关证明材料复印件：单位证照（统一社会信用代码证）、法定代表人身份证、上年度的财务报表、上年度的纳税证明、获得相关资质或能力评估的证明文件，AEC-Q100 认证需提供 AEC-Q100 认证费用发票、汽车电子客户年产值超过 5000 万元的证明材料以及形成销售的合同，获批国家级创新中心建设的单位需提供中标文件、项目合同、国家资金下达通知、收款回执单等。

3.相关情况报告：

（1）基本情况：所有制性质、注册资金、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况等；

（2）投资情况：研发费用情况，项目或产品总投入情况，资金来源等；

4.无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

5.项目申报承诺书（模板见附件 19）。

四、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

推进公共服务平台建设与服务项目申报指南 (A8)

一、扶持领域和对象

该项目扶持领域和对象为在无锡高新区（新吴区）登记、注册和纳税的集成电路企业，且申报项目发生于 2021 年。

二、申报条件

1. 第三方平台需经无锡国家“芯火”双创基地（平台）认定，并承担以下公共服务：EDA 共享、设计服务、人才培养、测试分析等。

2. 2021 年内实际建设投入（包含设备采购费用、企业运营费用、研发投入费用），以第三方机构审计结果为基数。

三、扶持标准

1. 对获得无锡国家“芯火”平台认定的专业公共服务平台，一次性给予当年实际建设投入 5% 的补贴，最高不超过 200 万元。

2. 对集成电路设计企业购买无锡国家“芯火”平台公共技术服务的，给予实际发生费用 50% 的支持（不含流片、IP 等服务），单个企业年度支持总额不超过 30 万元。

四、申报材料

1. 项目申报书（模板见附件 18）；

2.相关材料复印件：单位证照（统一社会信用代码证），法定代表人身份证，上年度的财务报表，上年度的纳税证明，专业公共服务平台认证证明，采购合同及发票，平台建设专项审计报告；

3.相关情况报告：

（1）企业基本情况：所有制性质、注册资金、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况等；

（2）平台或服务基本情况：项目基本情况，主要客户名单、发票和付款凭证，技术工艺情况，项目创新、先进性、知识产权情况，主起草标准及证明材料等；

（3）投资情况：研发费用情况，项目或产品总投入情况，资金来源等；

4.无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》；

5.项目申报承诺书（模板见附件19）。

五、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

支持集成电路企业参加展会申报指南（A9）

一、扶持领域和对象

该项目扶持对象为在无锡高新区（新吴区）登记、注册和纳税的集成电路企业，申报的参会活动需在 2021 年度内完成。

二、申报条件和扶持标准

1.支持企业参加境内外顶级专业展销会、博览会等，对符合条件的，按照参展展位费、特装费、公共布展费等实际支出费用的 60%给予补贴，最高支持不超过 30 万元。支持会议包括：中国集成电路制造年会（CICD）、中国半导体行业协会集成电路设计分会年会（ICCAD）、中国集成电路设计创新大会（ICDIA）、中国国际半导体博览会（IC China）、国际半导体展览会（SEMICON）、中国通信集成电路技术应用研讨会（CCIC）、世界半导体大会（WSCE）、中国半导体设备年会（CSEAC）、中国半导体封装测试技术与市场年会、慕尼黑电子展。

2.区内企业或专业机构开展集成电路领域行业沙龙、产业高峰论坛等活动的，经区工信局审批，按实际费用的 30%给予支持，总额不超过 50 万元。

3.对于国家级会展或其它有行业重大影响的活动，可根据实际情况采用“一事一议”方式给予支持。

三、申报材料

1.项目申报书（模板见附件 18）；

2.相关证明材料复印件：

（1）单位证照（统一社会信用代码证）；

（2）法定代表人身份证；

（3）相关费用支出财务凭证复印件，境外发票还需提供银行付汇单。

3.相关情况报告：

无锡高新区（新吴区）组织市场开拓活动通知，或委托组织市场开拓活动证明和活动通知，或展会参展确认函、参展合同、现场照片等布展相关证明材料。

4.无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人公共信用评价报告》。

5.项目申报承诺书（模板见附件 19）。

四、联系方式

区工信局信息产业处 熊 涛，电话：81890922；

区工信局信息产业处 臧 鑫，电话：81891293；

无锡市半导体行业协会 陈立明，电话：85380170。

支持关键人才引进和扎根（安家费） 申报指南（B1-1）

一、扶持领域和对象

该项目扶持领域和对象为在无锡高新区（新吴区）登记、注册和纳税且完成入库的集成电路企业，引进和留住的关键骨干、研发人才及顶尖人才。

二、申报条件

2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，新吴区内集成电路企业新招聘在区内首次就业的人才，满足下列条件之一：

1. 学历达到本科及以上；
2. 职称达到中级及以上；

3. 已获无锡高新区集成电路产业推进工作领导小组认定的顶尖人才，顶尖人才认定表详见下文。

三、扶持标准

本科或中级职称每人 2 万元；硕士或副高职称每人 5 万元；博士或正高职称每人 8 万元；顶尖人才，最高支持 300 万元。

四、申报要求

资金申报以企业为主体，各单位汇总满足条件的工作人员名单，在单位内部公示 3 天后，统一上传材料进行申报。原则上不

接受个人申报。

五、申报材料

以下材料提供扫描件：

- 1.人才身份证；
- 2.个人学历学位证书（海外学历还需增加国家教育部留服中心出具的海外学历学位证明）或职称证书；
- 3.个人在锡社保缴纳证明材料；
- 4.劳动合同证明材料；
- 5.公司内部公示名单及现场照片等证明材料；
- 6.项目申报承诺书（模板见附件 19）。

六、顶尖人才认定表：

- 1.获得以下奖项之一者：

诺贝尔奖获得者（物理、化学、生理或医学）、中国国家最高科学技术奖、科普利奖章、图灵奖、菲尔兹奖、沃尔夫数学奖、阿贝尔奖、拉斯克奖、克拉福德奖、日本国际奖、京都奖、邵逸夫奖、美国国家科学奖章、美国国家技术创新奖章、法国全国科研中心科研奖章、英国皇家金质奖章等。

- 2.担任以下国家级学术机构的院士：

中国、美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加拿大、瑞典、丹麦、挪威、芬兰、比利时、瑞士、奥地利、荷兰、西班牙、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、以色列、印度、乌克兰、新加坡、韩国等国的科学院、工程院。

3.国家重大人才工程入选者(限顶尖类)。

4.近 10 年内担任过“世界 500 强”即美国《财富》杂志每年评选的“全球最大 500 家公司”首席执行官、首席技术官或同等职位的人员。

5.担任过以下国际著名学术组织主席、副主席：

美国电气和电子工程师协会（IEEE）、英国电气工程师学会（IEE）、国际电工委员会（IEC）、美国物理学会（APS）、美国计算机协会（ACM）、美国机械工程师学会（ASME）、美国工业与应用数学学会（SIAM）、美国航天航空学会（AIAA）。

6.担任过以下世界知名大学校长、副校长：

上海交通大学高等教育研究院《世界大学学术排名》或泰晤士报《全球顶尖大学排行榜》排名前 100 名的境内外大学，限申报时最新排名。

7.担任过全国性半导体协会各专委会理事长、副理事长、秘书长、副秘书长。

8.其他相当于上述层次的集成电路行业人才。

七、联系方式：

区人社局人才开发处 林艳艳，电话：81891422；

支持关键人才引进和扎根（薪酬补贴） 申报指南（B1-2）

一、扶持领域和对象

该项目扶持领域和对象为在无锡高新区（新吴区）登记、注册和纳税，且完成入库的集成电路企业工作的副总经理以上管理人员和研发人员

二、申报条件

满足下列条件之一：

1.在集成电路企业工作、年薪 50 万以上的副总经理以上管理人员和研发人员；

2.在集成电路设计、关键装备及核心零部件企业工作、年薪 30 万以上的副总经理以上管理人员和研发人员；

3.已获无锡高新区集成电路产业推进工作领导小组审议认定、年度累计工作满 90 天以上、纳税额满 30 万元以上的境内外高端人才和紧缺人才。

三、扶持标准

在集成电路企业工作的副总经理以上管理人员和研发人员，年薪 50 万以上的，每人每年 6 万元薪酬补贴；年薪 80 万以上的，每人每年 10 万元薪酬补贴；

在集成电路设计、关键装备及核心零部件企业工作、年薪30万以上的副总经理以上管理人员和研发人员，每人每年3万元薪酬补贴；

在集成电路企业工作且满足条件的境内外高端人才和紧缺人才，按照个人所得税实际纳税额与按15%比例纳税额之间的差额部分给予补贴。

四、申报要求

资金申报以企业为主体，各单位汇总满足条件的工作人员名单，在单位内部公示3天后，统一上传材料进行申报。原则上不接受个人申报。

五、申报材料

以下材料提供扫描件：

- 1.人才身份证；
- 2.劳动合同证明材料；
- 3.由用人单位盖章的任职证明、工资发放明细等证明材料；
- 4.个人在锡缴纳个人所得税或社保缴纳的相关证明材料；
- 5.公司内部公示名单及现场照片等证明材料；
- 6.项目申报承诺书（模板见附件19）。

五、联系方式：

区人社局人才开发处 林艳艳，电话：81891422；

附件 18

无锡高新区（新吴区） 集成电路产业发展资金项目申报书

（2022 年度）

项目名称：_____

项目类别：_____

申请单位：_____（公章）_____

注册地址：_____

项目联系人：_____联系电话（手机）：_____

所属版块：_____

申报日期：2022 年 月 日

编写内容及要求

申请报告纸张规格：A4，页边距：上 3.7cm，下 3.5cm，左 2.8cm 右 2.6cm，字体：仿宋体三号字，行间距 28，内容简洁，表述清晰，不超过 5000 字，必要时可用图形或表格形式表现，主要包括但不限于以下内容，并提供胶装纸质材料 2 份。

一、申报单位基本情况（项目申报单位及主要参与单位的基本情况）

（一）单位概况：主要业务、资本性质、组织结构、财务状况、经营情况等；

（二）技术水平：研发队伍、科研成果、知识产权、提供技术支持和服务的能力、条件等情况；

二、项目情况

（一）项目实施内容（包括组织方式、技术路径和系统方案、示范内容及规模、产学研合作情况、项目规划和推广、技术保障和系统维护等）；

（二）项目总投资及资金来源情况，申请各级财政资金情况。

三、项目绩效目标（创新成果、经济指标及社会指标）

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，示范效果的社会和经济效益分析。

四、申报金额统计（含政策条款及计算过程）

附件：（内容见“申报指南”对应附件）

项目申报承诺书

_____公司/项目郑重承诺：

本公司已充分阅知无锡高新区（新吴区）集成电路产业发展资金项目申报要求，此次申报项目所提交的申报材料均真实、合法，如有不实之处，愿承担相应法律责任，并担负由此带来的相应后果。

本单位承诺在享受区内政策扶持后，在高新区经营不低于十年，从最晚一次享受政策扶持开始，五年内不注销、迁移到区外发展，不在高新区外另设公司弱化区内公司实际业务运作。若违反，退还所有补贴资金。

单位盖章处

法定代表人签字：

日期：